

深圳市路维光电股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，践行以“投资者为中心”的发展理念，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”或“路维光电”）特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。方案具体内容如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

作为中国掩膜版行业的先行者，路维光电是国内领先的专业第三方掩膜版厂商。公司坚持以“以屏带芯”为战略锚点，为下游知名显示厂商、晶圆厂商、IC设计公司、封测厂商以及设备厂商等提供专业的掩膜版产品以及高效的后续服务。近30年来，凭借持续自主研发创新与稳步扩产，公司已成为国内高世代、高精度平板显示掩膜版和先进封装掩膜版龙头供应商，半导体制程布局国内领先（14nm）。

凭借深厚的行业洞见和专业的研发实力，公司构建了丰富的产品矩阵。在显示领域，公司是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）的本土掩膜版企业，实现全显示技术覆盖（LCD、AMOLED、LTPS、LTPO、Mini-LED、Micro-LED、硅基OLED、FMM用掩膜版等）；近年来，公司紧跟下游平板显示行业的技术前沿和发展动态，坚持研发攻关和技术创新，持续突破平板显示掩膜版关键技术，率先在国内突破高精度半色调掩膜版等尖端制造技术，并针对上游原材料“卡脖子”问题，攻克了光阻涂布等多项产业链上游核心技术。为巩固并扩大在下一代显示技术领域的领先优势，公司于2025年7月启动厦门高世代高精度掩膜版生产基地建设，重点将聚焦于G8.6及以下各类掩膜版产品的研发与生产，以精准匹配国内高端面板产线的快速增长需求，进一步强化公司的市场供给能力与核心技术壁垒。

经过近三十年的技术研发与产品开发，公司积累了丰富的客户资源，在平板显示掩膜版领域，公司服务的主要客户包括京东方、天马微电子、信利、TCL华星、上海显耀（JBD）、寰采星等；在半导体领域，公司服务的主要客户包括国内某领先芯片公司及其配套供应商、某三维多芯片集成龙头（2.5D/3D）、华天科技、

宁波中芯集成、晶方半导体、通富微电、三安光电、光迅科技等，路维光电已经成为掩膜版行业知名供应商。

报告期内，公司实现营业收入 115,523.17 万元，较上年同期增加 31.94%。主要得益于公司产能有序提升，加之下游行业需求旺盛。从收入结构看，OLED 用掩膜版、G8.6 以及 G11 等高附加值掩膜版的增速明显，带动平板显示掩膜版的整体增长；公司的第二成长曲线半导体掩膜版发展前景广阔，尤其是 IC 制造掩膜版的表现亮眼。随着新增投资项目产能的陆续释放，公司期待在未来可以实现双轮驱动发展。规模效应释放与产品结构持续优化，同时公司持续强化运营管理，盈利能力得以加强；报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 25,198.43 万元，较上年同期增加 32.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,031.38 万元，较上年同期增加 32.58%。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

公司可转换公司债券募投项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”稳步推进，部分产线处于产能投产爬坡阶段；该项目产品涵盖 250nm-130nm 半导体掩膜版和 G8.6 及以下各类高精度平板显示掩膜版产品。

公司投资建设的路芯半导体掩膜版项目进展顺利，制程节点布局居于国内厂商前列。该项目一期产品覆盖 130-40nm 制程节点半导体掩膜版，2025 年已逐步实现产品量产，实现 90nm 及以上成套掩膜版客户端验证通过并供货，40nm 和 28nm 单片掩膜版客户端验证通过并供货，并持续推进 40nm 成套掩膜版客户端送样工作；二期布局 28-14nm 半导体掩膜版，计划于 2026 年陆续投建。未来伴随项目的顺利投产，其产品将逐步覆盖 MCU（微控制芯片），SiPh（硅光子）、CIS（互补金属氧化物半导体图像传感器），BCD（双极-互补-双扩散-金属氧化物半场效应管），DDIC（显示驱动芯片），MS/RF（混合射频信号），Embd. NVM（嵌入式非易失存储器），NOR/NAND Flash（非易失闪存），DRAM（动态随机存取存储器）等半导体制造相关行业，进一步完善产业链供给、推动国产替代进程。

为进一步扩充公司高世代高精度掩膜版的产能，公司于厦门市投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”。该项目总投资额为人民币 20 亿元，计划建设 11 条高端光掩膜版产线，重点研发生产 G8.6 及以下各类高精度光掩膜版，项目已于 2025 年 7 月完成奠基仪式，2026 年 1 月封顶。项目分阶段实施，其中一期计划总投资额 13 亿元，将建设 5 条 G8.6 及以下 AMOLED 高精度掩

膜版产线，配置 5 台（套）核心主设备及 22 台（套）精密辅助设备。目前，一期项目设备已开始有序采购，预计 2026 年设备将陆续到厂并进行安装调试、投入生产。该项目投产后，公司产能将显著提升，能够更充分地满足下游客户需求，助力公司持续提升在客户供应链中的份额，加速推进国产化替代进程，进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。

凭借优秀的产品性能与优质的服务，公司吸引了更多优质客户，2025 年公司新增客户 170 家，总合作客户 500 余家，其中公司在 100 多家长期合作客户的销售收入实现超 30% 的增长，在国内某领先芯片公司及其配套供应商、京东方、天马微电子、TCL 华星、三安光电等客户供货量有较快提升。

2026 年，公司将稳步开展经营活动，推进募投项目及自有资金建设项目，扩大生产规模，优化产线和产品结构，通过技术升级提高产品质量和生产效率。在平板显示用掩膜版领域，公司将加大高端掩膜版产品研发，扩大新技术及高端掩膜版产品的销售规模；在半导体用掩膜版领域，公司将继续加大更高技术节点掩膜版的研发和量产力度，持续提升产品精度，丰富产品种类，以满足更广泛的市场需求。

二、以技术攻坚铸壁垒，发展新质生产力

技术创新和业务升级是适应快速变化市场环境的必由之路，公司始终坚持以市场为导向，将技术研发与客户需求定制化作为核心驱动力，持续提升产品和服务的质量和竞争力。报告期内，公司完成了多项技术研发项目，如光刻机特殊结构开发、化学药液对石英表面特性的影响研究与高精度产品脱膜工艺开发、高精度半导体掩膜版清洗能力提升项目等等。针对具体产品研发方面，公司开展了 G8.6 AMOLED 产品、G8.6 FMM 用掩膜版产品、FOPLP 面板级封装用掩膜版产品开发等研发项目，配套国内 G8.6 AMOLED 面板产线及 FOPLP、TGV 等先进封装工艺产线配套所需的掩膜版产品。在过往研发成果的基础上，公司成功实现多个尺寸平板显示用 PSM 量产，进一步丰富公司产品种类，为提升公司在掩膜版领域的技术实力打下坚实基础。公司积极布局 AI 在图档处理中的应用以提升效率，开发外框 barcode 图形坐标计算和生成系统，实现批量自动化设计，提高外框 barcode 图档文件处理效率；针对封装行业 ODB++（一种数据格式）的数据文件，优化数据处理流程，提高封装行业图形处理效率。

公司产品技术国内领先，多次打破海外垄断。（1）在 G11 高精度超大尺寸掩

膜版领域，公司于 2019 年成功建设国内首条 G11 高世代掩膜版产线并投产，成为国内首家且唯一一家、世界第四家掌握 G11 掩膜版生产制造技术的企业；（2）在半色调掩膜版领域，公司于 2018 年成功实现 G2.5 等中小尺寸半色调掩膜版投产，并于 2019 年先后研发并投产 G8.5、G11 TFT-LCD 半色调掩膜版，2024 年量产 AMOLED 用 HTM 掩膜版产品，HTM 产品目前可以覆盖全世代，打破国外厂商长期技术垄断；（3）在 PSM 领域，公司于 2021 年完成衰减型相移掩膜版 (ATT PSM) 工艺技术研发并通过内部测试，2023 年量产 Metal Mesh 用 PSM 掩膜版，CF 用 PSM 产品于 2024 年通过客户验证并量产，2024 年完成单层衰减型 PSM 掩膜版制造技术及 Mosi 系双层 PSM 掩膜版制造技术研发；2025 年实现 G6、G8.5 TFT-Array 用单层衰减型 PSM 客户导入及量产，实现 i-line 的半导体 PSM 客户导入；（4）在材料技术领域，公司分别于 2016 年、2018 年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术，实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。

公司不断完善技术布局，加快研发成果转化。报告期内，公司相移掩膜版 (PSM) 荣获“2024 年度新型显示产业创新突破奖”，半色调 (half-tone) 掩膜版荣获 DIC WXP0 2025 “显示材料创新金奖”；新增 5 项核心技术，新获授权专利 16 项。截至报告期末，公司累计申请专利 183 件，软件著作权 34 件；有效授权专利 117 件，软件著作权 33 件。

2026 年，基于现有的技术优势，面向终端市场多样化不断催生的新技术、新形态，公司将顺应半导体和平板显示产业持续发展和创新的态势，在加强前瞻性技术探索的同时，持续捕捉市场需求、客户需求，不断深化新工艺、新技术的研究，提升公司核心技术转化能力和多品类产品定制化综合服务能力，推动掩膜版技术迭代升级，满足下游市场持续增长的需求；同时，公司将抓住国产替代的市场机会，增强高精度掩膜版产品自主可控的生产能力进一步提高公司在高端掩膜版的市场份额。针对生产流程中涉及的各类工艺技术，公司将深度挖掘改良优化空间，致力于以工艺革新赋能生产效能提升。公司将加强与高校、科研机构的合作，达到资源优化、产学研的有机结合，共同攻克行业关键技术难题。

三、持续完善公司治理，发挥“关键少数”积极作用

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规和监管要求，建立了由股东会、董事会、独立董事和高级管理层组成的治理结构；并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会专门委员会。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。不断完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制体系，规范公司运作，提升公司治理水平。

2025年10月，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司按照《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，进一步规范公司运作机制、持续完善公司治理结构及内部控制制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等28项治理制度，制定了《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司持续强化政策宣导与机制建设，压实“关键少数”履职责任，积极组织董事、高管和信息披露人员参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会组织的相关专项培训，持续提升相关人员的规范运作意识。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东、实际控制人杜武兵先生、公司持股5%以上的股东肖青女士自愿承诺自2025年8月18日起6个月内不以任何方式转让或减持其直接持有的公司股份，具体详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东自愿承诺不减持公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-060）。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，公司通过员工持股平台与第二类限制性股票等专业化激励工具，搭建起核心员工与公司风险共担、利益共享的长效激励机制，有效增强经营团队及核心骨干的忠诚度与稳定性，激发员工创新活力与发展动能，在吸引、保留和激励优秀人才方面发挥重要作用。2025年，2024年股权激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就，102名核心

骨干员工获得第二类限制性股票归属，总归属 381,972 股第二类限制性股票，同时 7 名核心骨干员工获授 2024 年股权激励计划预留授予的 235,400 股限制性股票；80 名核心骨干员工符合员工持股计划归属条件并获得归属，归属数量 265,508 股。上述激励进一步调动了员工积极性与主动性，持续提升公司长期经营能力与综合竞争力，为公司高质量、可持续发展注入强劲而持久的动力。

2026 年，公司将持续关注最新监管政策及法律法规，及时修订和完善公司治理制度，并强化制度的落实和执行。同时，公司将继续与大股东、董事、高级管理人员沟通联动，组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，提升“关键少数”合规意识和履职能力；通过传递资本市场监管案例、深化互动交流，多维度提升公司治理水平，切实维护全体股东利益，推动公司高质量发展。公司将严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，积极落实董事与高管薪酬管理制度，包括决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。公司将持续推进股权激励等工具在内的长效激励机制可行性研究，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，强化正向激励，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量、可持续发展。

四、提升投资者回报，共享高质量发展成果

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司统筹经营发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定股东分红回报规划并有效实施，为加强市值管理，积极开展回购，并制定了稳定股价预案，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。

2025 年，公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 9 日分别召开第五届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金红利 57,635,589.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》。

2026年，公司制定了2025年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；拟派发现金红利77,006,230.80元（含税），占本年度归属上市公司股东净利润的30.56%，本年度利润分配方案如下：

单位：元

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	4.00
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	77,006,230.80
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	251,984,299.40
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.56
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0.00
合计分红金额（含税）	77,006,230.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.56

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为179,630,840.44元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的91.08%，具体分红实施情况如下：

单位：元

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	251,984,299.40
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	238,376,501.53
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	179,630,840.44
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	179,630,840.44
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	197,215,843.30
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	91.08
最近三个会计年度累计研发投入金额	109,494,953.04
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.05

五、提升信息披露质量，加强投资者交流

公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2025年，公司积极通过投资者调研、E互动平台、投资者电话、电子邮箱等多种形式积极与投资者互动交流，并通过举办业绩说明会等方式实现公司与投资者双向有效沟通。报告期内，公司

召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，促进投资者对公司的全面了解，切实保护投资者的合法权益。

2026 年，公司将进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务。同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，公司将召开不少于 3 次业绩说明会，并通过视频或文字直播、定期报告等形式，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况；同时，公司将安排一系列投资者关系活动，包括参加券商机构组织的策略会、安排投资者现场调研、开展投资机构上门反路演等多种投资者交流活动，深入了解投资者的诉求，并在合法合规的范围内做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为投资者提供准确的投资决策依据，切实保障投资者权益。

六、其他事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

本报告是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日